

便簽 日期：
單位：研究發展處

計畫業務組 擬辦：

- 一、公告於電子公佈欄、本校首頁、研發處網頁、計畫業務組網頁，並e-mail副知各學院，請各學院轉知所屬系所及老師知照。
- 二、計畫申請說明會於2014年4月16日（星期四）下午14:00，（新竹科學工業園區管理局活動中心A館第一會議室）
- 三、欲申請者，請於103年05月02日前備文檢送相關申請資料送至本組，俾利本組備函辦理，逾期恕不受理。
- 四、陳閱後文存。

第二層決行	承辦單位	會辦單位	決行
行政 辦事員	方孔伶	0407 1029	
教授 組長	張嘉哲	0408 1035	
			代為決行
			教授 研究發展處 陳全木
			0408 1036



檔 號：

保存年限：

科技部新竹科學工業園區管理局 函

機關地址：30016新竹市新安路2號

聯絡人：張文榮

電話：03-5773311 分機2131

傳真：03-5788030

電子信箱：wjchang@sipa.gov.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國103年4月1日

發文字號：竹企字第1030009626號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本局103年度「MG+4C垂直整合推動專案計畫」自即日起至5月7日止受理申請，另訂於103年4月16日舉辦計畫申請說明會，歡迎廠商與學研機構踴躍參加，請查照轉知。

說明：

- 一、為推動台灣半導體產業下世代的成長動能，本局以科學工業園區內原有完整之半導體產業群聚及專業分工生態為基礎，並以智慧電子MG+4C(生醫、綠能、車用電子、資訊、通訊、消費性電子)重點產品為主軸，積極推動產業異業結盟及垂直整合。
- 二、本計畫以公開徵求整合型研發計畫方式，並以感測器(Sensor)為計畫重點扶植項目，透過政府之經費補助（每件計畫最高可補助新台幣2,000萬元），鼓勵智慧晶片系統上、下游廠商與學研機構合作，以MG+4C之創新、創意產品為應用領域，共同進行垂直整合研發，以加速市場切入時效，增進智慧電子整體產業競爭力。
- 三、有意申請者，請於103年5月7日（星期三）下午5時前備函檢送構想書等申請文件送達本局，逾期恕不受理。有關本計畫構想書等申請文件、實施方式及申請注意事項，請逕至本局網站（<http://www.sipa.gov.tw>）首頁→訊

國立中興大學

1030090S004567-1030401110615\$A09550000Q.di

第1頁，共2頁



1030004583 103/4/2

息公告→最新消息下載參考。

四、另為使廠商及學研機構了解本計畫內容並協助提出申請，本局特舉辦「申請說明會」：

(一)時間：103年4月16日（星期三）下午2時

(二)地點：本局活動中心A館第一會議室（原勞工育樂中心，新竹市新安路2-1號）

(三)報名方式：請參閱本局網站公告

五、如有計畫申請相關問題，歡迎洽詢本局承辦窗口：企劃組產學研發科，張先生，聯絡電話03-5773311分機2131；李小姐，分機2142。

正本：園區各事業（共510單位）、學研機構（共63單位）、財團法人國家實驗研究院晶片系統設計中心、財團法人國家實驗研究院儀器科技研究中心、財團法人國家同步輻射研究中心、財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心、財團法人國家實驗研究院太空中心、財團法人國家實驗研究院奈米元件實驗室、財團法人國家實驗研究院、台灣科學工業園區科學工業同業公會、財團法人農業科技研究院台灣動物科技研究所、智慧電子國家型科技計畫辦公室

副本：科技部、本局企劃組、博大股份有限公司(竹科辦公室)



代理局長 杜啟祥